

证券代码：301511

证券简称：德福科技

# 九江德福科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	华泰柏瑞基金管理有限公司 天风证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 广发证券股份有限公司
时间	2025年1月9日 15:00-16:00
地点	江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理 江洪博士 副总经理 范远朋博士 副总经理、董事会秘书 吴丹妮女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、介绍公司发展历程、基本业务及研发情况</b></p> <p>公司成立于1985年，前身为九江电子材料厂，生产、销售、研发电解铜箔业务40年。2015年前以电子电路铜箔业务为主，2015年开发锂电铜箔产品，2017年进行股份制改革，2021年产业资本长江晨道、LG化学、赣锋锂业、万向一二三等增资入股公司，2023年8月公司在深交所创业板上市。</p> <p>公司主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，产品按照应用领域可分为电子电路铜箔和锂电铜箔。2020年初总产能为1.8万吨/年，截至2024年三季度，公司产能至15万吨/年，2025年2季度将有2.5万吨在建产能投产试运行。公司实现自主开发核心添加剂、耗材及设备，不断实现产品、工艺和技术革新。截至2024年三季报，公司研发团队拥有来自北京大学、清华大学、中国科学技术大学、厦门大学等高校博士17人、截止2024年12月博士研发人员升至19人，硕士百余人并教授级高级工程师1人、高级工程师2人等多名行业资深专家，研发团队背景及综合能力、研发投入位居同行业前列。</p> <p><b>二、问答环节</b></p> <p><b>1、德福科技在高端电子电路领域的具体新产品、新客户或进展是什么？以及今年的具体出货量是多少？</b></p> <p>答：电子电路领域从铜箔应用到覆铜板，再到PCB，IC封装载板，再到终端，需经过1-3年的认证周期。公司2018年起组建夸父实验室，致力于高端电子电路铜箔转型升级。精细线路领域所使</p>

用的带载体可剥离超薄铜箔是制备难度最高的铜箔产品之一，该产品技术多年被外资铜箔公司垄断。公司自主研发的超高端载体铜箔陆续在载板企业送样验证，相关产品性能及可靠性已通过某存储芯片龙头公司的验证和工厂制造审核，2025年起将陆续替代进口产品。

高频通信及高速服务器市场目前公司已实现大量国产化替代，高端应用已通过深南电路、胜宏科技等PCB厂商的验证，并在英伟达项目中实现应用。预计2025年高频高速PCB领域和AI应用终端涉及的公司HVL1-4代产品、RTF1-3代产品出货将达数千吨级别。

## 2、公司在锂电铜箔有何技术优势？

答：公司紧跟锂电铜箔轻薄化的发展趋势，于2018年完成6 $\mu$ m高抗拉锂电铜箔的开发，该产品运用自主研发的电解添加剂复配技术，抗拉强度和延伸率等关键技术指标达到领先水平；2020年，公司进一步掌握6 $\mu$ m高模量锂电铜箔、4.5 $\mu$ m高抗拉锂电铜箔量产技术；2021年，公司研发出多款高模量、高延伸锂电铜箔，产品抗拉强度、弹性模量以及延伸率等指标具有行业领先优势；2022年以来，公司以上高附加值产品陆续实现批量出货。

公司锂电铜箔研发将继续围绕“高抗拉、高模量、高延伸”的方向，结合下游需求发展情况、持续加强研发投入，以保持产品技术领先优势及长期竞争力。

## 3、公司在硅基负极电池领域进展如何？

答：目前高端数码产品如手机和无人机等新型消费电子，对续航能力的需求持续高涨。由于这些产品的空间体积有限，对能量密度的要求尤为严格。长期以来，业界探索使用硅碳或硅氧负极替代或掺杂石墨，以利用其更高的锂嵌套能力来提升能量密度。然而，硅负极的立体结构导致其在充放电过程中体积膨胀巨大，远超石墨材料，普通铜箔无法挑战其高膨胀和回缩能力，易出现鼓包、断裂等问题。

对此，公司已开发出同样厚度下两倍以上抗拉强度和延伸率的新产品，可最大限度提升硅负极电池的循环稳定性。目前公司已与多家客户建立深度战略合作关系，该款产品已在高端手机和无人机项目中实现批量稳定出货，月出货量超百吨，附加值高，该产品系市场独供，对业绩贡献显著。与此同时，公司2025年应用在硅碳材料的特种铜箔有望实现动力电池方向增量，此等增量是下游应用单体几十克到几十公斤的数量级变化，在目前行业同质化产品过剩和公司锂电满产的情况下，实现高端产品结构改善。

## 4、公司在固态电池领域进展如何？

答：半固态电池和全固态电池在研的解决方案较多，安全性相对提高但能量效率未有本质提升。针对固态电池的发展路径，经过公司持续研发，同时与多家客户深入合作下取得了一些突破，现已开发出孔状铜箔和雾化铜箔两种适合不同应用场景的负极集流体解决方案。目前公司持续跟进三十余家多次送样测试客户。并肩负客户探索新的负极材料替代方案，以达到更高的能量密度和更好的稳定性。

## 5、公司高附加值产品占比结构及未来预期？

答：截至2024年中报，公司锂电产品中高附加产品占比39.64%，电子电路产品中高附加值产品占比达16.15%，公司2025年目标是全年锂电高附加值产品占比升至60%，电子电路高附加值产品占比升至20%。

锂电铜箔方面，目前锂电硅负极、高端数码、高端动力类都在增

	<p>长，头部电芯厂商对中高强度产品的需求量比达 50%，产业的迭代升级也较为明显，增长趋势明显，公司产品高端差异化发展战略笃定前行。</p> <p>电子电路铜箔方面，作为电子产品的神经传导载体，AI 时代下高端电子产品的应用对其发展有极大促进作用，公司专注电子电路铜箔行业 40 年，必将努力把握国产化机遇，践行大国工匠精神，铸铜箔工业之典范。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年1月9日